



ENGLISH
清华主页



- 首页
- 头条新闻
- 综合新闻
- 要闻聚焦
- 媒体清华
- 图说清华
- 视频空间
- 清华人物
- 校园写意
- 专题新闻
- 新闻排行
- 新闻合集

首页 - 综合新闻 - 内容

清华大学举办第三届未来芯片论坛
《人工智能芯片技术白皮书（2018）》同期发布

清华新闻网12月17日电 12月10日-11日，由北京未来芯片技术高精尖创新中心和清华大学微电子学研究所联合主办的“第三届未来芯片论坛：可重构计算的黄金时代”在清华大学主楼举办，并正式发布了《人工智能芯片技术白皮书（2018）》。清华大学副校长郑力出席论坛并致开幕辞。



郑力致辞

郑力表示，清华大学始终坚持“中国特色、世界一流、清华风格”的发展道路，秉承“顶天 立地 树人”的科研宗旨，在全面推进综合改革、加快“双一流”建设的同时，将进一步发挥人才、教育和科研的优势，为高精尖创新中心的建设和发展提供全力支持。



余成斌致辞

中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长、新思科技中国区研发总监余成斌表示，中国集成电路产业近几年实现高速发展，科技创新是中国集成电路产业发展的原始驱动力。



梅宏作、魏少军、尼克·达特作特邀报告

北京理工大学梅宏院士、清华大学微电子学研究所所长魏少军教授、加利福尼亚大学欧文分校尼克·达特教授分别带来题为“软件定义的世界：现状和未来面临的挑战”“软件定义芯片，让芯片更加智能”“自适应弹性芯片的自我意识原理”的特邀报告。此外，围绕“架构”“应用”“系统与工具”“电路与器件”等研究角度，论坛还进行了22场主题报告和2场专家讨论。

论坛期间，北京未来芯片技术高精尖创新中心正式发布了《人工智能芯片技术白皮书（2018）》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》首次整合了国际化的学术和产业资源，紧扣学术研究和产业发展前沿，对人工智能芯片技术进行了深入探讨、专业阐述，提出了“AI 芯片基准测试和发展路线图”、完成了对AI芯片各种技术路线梳理及对未来技术发展趋势和风险预判，对于AI芯片技术未来将如何发展具有重要的启示意义。



白皮书发布仪式

《白皮书》由北京未来芯片技术高精尖创新中心邀请斯坦福大学、清华大学、香港科技大学、台湾新竹清华大学及北京半导体行业协会，新思科技等在内的领域顶尖研究者和产业界资深专家，包括10余位国际电气与电子工程师协会会员（IEEE Fellow）编写完成。随着底层芯片技术的进步，人工智能算法也将获得更好的支持和更快的发展。而在这一过程中，人工智能本身也很有可能被用于研发新的芯片技术，形成算法和芯片相互促进的良性循环局面。通过《白皮书》，可以清晰地看到人工智能芯片是人工智能产业和半导体产业交叉融合的新节点，涉及多个学科、多个领域的理论和技术基础，突显对基础扎实、创新能力强的人才的需求。



未来芯片论坛是北京未来芯片技术高精尖创新中心和清华大学微电子学研究所共同创办的年度品牌会议，至今已举办三届。每年论坛均邀请了数十余位国内外科技大咖做客清华，共同探讨芯片前沿技术趋势，分享最新研究成果。

供稿：北京未来芯片技术高精尖创新中心 编辑：赵妹婧 审核：襄楠

2018年12月17日 13:53:08 清华新闻网

相关新闻

更多 >图说清华



【组图】学生社区发展十五载 致敬改革开放四十年



【组图】欢歌共聚清华园 携手追梦又一年



【组图】2019清华大学国际学生学者新年晚会异彩纷呈



【组图】学生社区发展

- 1
- 2
- 3

最新更新

41

今天

【良师益友20周年】李翔宇：高尚的师德 不悔的选择

49

今天

【身边榜样】梅生伟：在西部，坚守清华人的使命与责任

61

今天

【甲团30年】经47：德智体美，全面发展

200

今天

【组图】学生社区发展十五载 致敬改革开放四十年

8

今天

【专题】2018，我们共芳华！

277

今天

研工部联合物业中心在学生公寓试点建设党员活动室

182

今天

清华大学研究生会2018年度总结表彰会举行 王展硕当选为新一任研究生会主席

83

今天

2018校园戏曲节在清华大学落幕

66

今天

中宣部教育部共青团中央部署开展“改革先锋进校园”活动

644

01.01

【微观清华】2018清华大学学生年度人物揭晓



